

芯片IC失效分析开封测试

产品名称	芯片IC失效分析开封测试
公司名称	深圳市启威测标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道甘李五路1号科伦特研发楼附属楼101（启威测实验室）
联系电话	0755-27403650 13631643024

产品详情

为什么要进行芯片IC开封测试？

产品不能正常工作了，就是所谓的失效，选取PCB板上IC进行分析，去除IC外封胶及塑封体观察晶圆表面是否有损伤;

芯片IC开封测试原理及步骤？

切开剖面观察金丝情况，及金球情况，表面铝线是否受伤，芯片是否有裂缝，光刻是否不良，是否中测，芯片名是否与布线图芯片名相符。

使用强酸将塑封器件芯片上方的塑料蚀掉，观察：

芯片金线焊接情况;

芯片内部线路情况;

芯片表面是否出现EOS